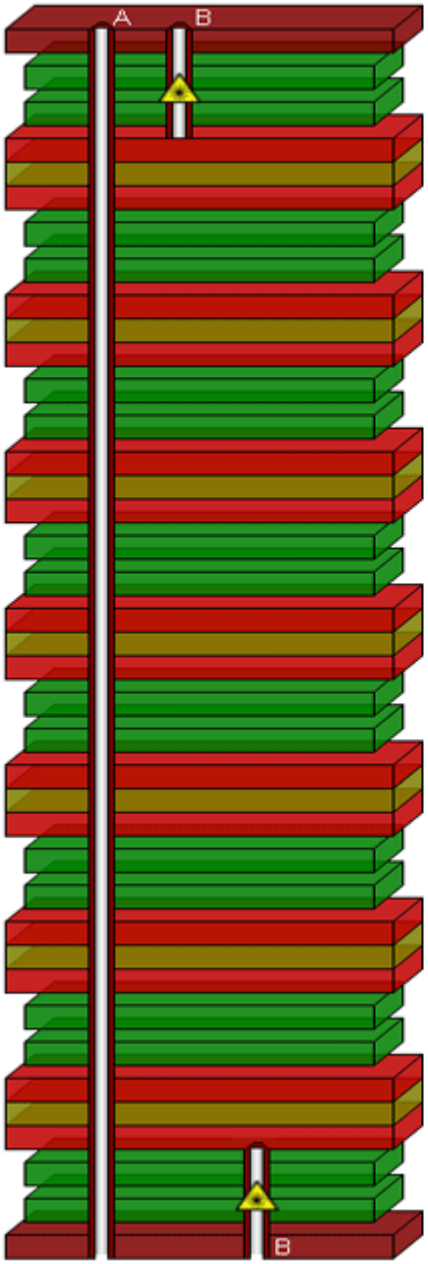
Multilayer 16 Lagen - 1,8 mm - Microvia

Lagenaufbau



Ebene	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1	Cu+galv.Cu		9+25	
	Prepreg	0.048		106
	Prepreg	0.048		106
2	Cu		18	
	Tr-Lam	0.10		
3	Cu		18	
	Prepreg	0.048		106
	Prepreg	0.048		106
4	Cu		18	
	Tr-Lam	0.10		
5	Cu		18	
	Prepreg	0.048		106
	Prepreg	0.048		106
6	Cu		18	
	Tr-Lam	0.10		
7	Cu		18	
	Prepreg	0.048		106
	Prepreg	0.048		106
8	Cu		18	
	Tr-Lam	0.10		
9	Cu		18	
	Prepreg	0.048		106
	Prepreg	0.048		106
10	Cu		18	
	Tr-Lam	0.10		
11	Cu		18	
	Prepreg	0.048		106
	Prepreg	0.048		106
12	Cu		18	
	Tr-Lam	0.10		
13	Cu		18	
	Prepreg	0.048		106
	Prepreg	0.048		106
14	Cu		18	
	Tr-Lam	0.10		
15	Cu		18	
	Prepreg	0.048		106
	Prepreg	0.048		106
16	Cu+galv.Cu		9+25	

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com

Presslingsdicke *	1,77	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstoppmaske *	1,88	+/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 250 µm
	Viapad-Ø	≥ 550 µm
Lasersacklöcher [B] (blind Vias)	End-Ø	≥ 100 µm
	Viapad-Ø	≥ 350 µm
Leiterbild Außenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥80 µm ≥ 100 µm
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 100 µm ≥ 120 µm
Leiterbild Innenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥65 µm ≥80 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 85 µm ≥ 100 µm

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com